

招待会社名 Invited by

# 電子機器2023

## トータルソリューション展

5.31 Wed. → 6.2 Fri. 10:00-17:00

東京ビッグサイト 東展示棟 2~6ホール+会議棟

完全WEB登録制 事前登録 パッと登録! パッと入場!

事前登録のうえ、来場者パスを出力しお持ちいただいた方は、当日会場内設置のパスホルダーをピックアップいただくだけでスムーズにご入場いただけます。

会場登録はこちらのWEBから [www.jpccashow.com/](http://www.jpccashow.com/) 招待状

入場料:1,000円(税込) WEB登録にて無料

ここから始まる! ~ Exhibition X ~

www.jpccashow.com

### 来場のご案内

電子機器トータルソリューション展はWEB登録制となります。事前にWEBにて登録をお願い致します。本招待状のみでは入場できませんのでご注意ください。

#### STEP.1

公式ホームページより来場登録へお進みください。

#### STEP.2

ご登録いただいたメールアドレス宛に、パスワード設定のメールが届きます。24時間以内にパスワードの設定を完了してください。パスワード設定のメールが届かない場合は、事務局までお問合せください。

#### STEP.3

展示会当日、来場者マイページより「来場者証(来場者パス)」をプリントアウトし、四つ折りの状態で持参してください。パスケースをピックアップ頂き、来場者証を中に入れ、会場入り口にてバーコードをご提示ください。

公式HPはこちら

事前登録/最新情報はHPをご覧ください

### 開催概要

**JPCA Show 2023**

第52回 電子機器トータルソリューション展

主催: 一般社団法人日本電子回路工業会

**JIEP**

第37回 最先端先端技術シンポジウム

主催: 一般社団法人エレクトロニクス工業会

**JISSO PROTEC 2023**

第24回 最先端先端技術シンポジウム

主催: 一般社団法人日本電子回路工業会

**5G**

SDGx5G

共催: 一般社団法人日本電子回路工業会

**WIRE Japan Show**

第10回 最先端先端技術シンポジウム

共催: 一般社団法人日本電子回路工業会

**Electronics Component & Unit Show**

第10回 最先端先端技術シンポジウム

共催: 一般社団法人日本電子回路工業会

会場: 東京ビッグサイト 東展示棟2~6ホール+会議棟

入場料: 1,000円(税込) ※招待券持参者及びWEB登録で無料

本部署: 一般社団法人日本電子回路工業会

運営事務局: 株式会社JTBコミュニケーションデザイン

主催: 経済産業省(特選)

### 来場者参加型企画

#### ウェアラブル製品のデモ展示

今後さらなる市場拡大が見込まれる高機能のウェアラブルの技術を見て触れていただき、より身近に感じていただけます。

#### 実装体験コーナー

工作キットを用い、簡単なハンダ付けを体験いただけます。半導体関連企業の新入社員や製造に携わる機会のない部署の社員の方、学生の方にもおすすめです。

#### 主催者テーマ展示

「新しい基板の用途」や「基板製造プロセス」のテーマ展示を設けるとともに、基調講演やヒューマンコンピュータインターフェース、ウェアラブルデバイスなどの注目すべき講演と運動した特別展示を実施します。

### 電子機器トータルソリューション展 基調講演 (JPCA 創立60周年記念)

聴講料: 会員・VIP 無料、非会員 20,000円 / 1セッション (聴講料は税込です)

5月31日(水)	6月1日(木)	6月2日(金)
<p>10:45-11:30</p> <p>SDGs電子デバイス</p> <p>メタバースとSDGsで高成長を狙う! ~ニホンパ及び世界の半導体の大型プロジェクトに注目~</p> <p>泉谷 渉 株式会社ニホンパ 代表取締役社長</p>	<p>10:45-11:30</p> <p>自動車</p> <p>すべての人に移動の自由を -トヨタの自動運転技術開発の取組み-</p> <p>藤岡 健 トヨタ自動車 本車種開発センター Chief Project Leader / Fellow</p>	<p>10:45-11:30</p> <p>半導体の未来</p> <p>半導体、半導体製造装置 その未来と課題</p> <p>寺本 章伸 広島大学 ナノデバイス研究所 所長・教授</p>
<p>11:45-12:30</p> <p>半導体/パッケージ</p> <p>半導体・デジタル産業戦略の現状と今後</p> <p>長野 洋平 経済産業省 高成長政策局 デバイス・半導体戦略室 室長</p>	<p>11:45-12:30</p> <p>ロボット/自動化</p> <p>製造業が直面する労働力問題と電子業界への自動化の提案 ~製造現場に導入しやすい自動化を目指して~</p> <p>山口 賢治 ファナック株式会社 代表取締役社長 兼 CEO (一社) 日本ロボット工業会 会長</p>	<p>11:45-12:30</p> <p>日本の半導体戦略</p> <p>~More Moore, More than Moore, More People~</p> <p>黒田 忠広 東京大学 大学院工学系研究科附属システムデザイン研究センター 教授</p>
<p>13:30-14:15</p> <p>脱炭素社会の実現に向けて、ますます重要となるパワー半導体とアナログ技術</p> <p>松本 功 ローム株式会社 代表取締役社長 社長執行役員 CEO</p>	<p>13:30-14:15</p> <p>ウェアラブル/E-Textile</p> <p>ウェアラブルデバイスの切り拓く 人間とコンピュータの新たな関係 ~医療・健康・教育・エンタテインメント~</p> <p>寺田 努 コネクテックジャパン株式会社 代表取締役社長</p>	<p>13:30-14:15</p> <p>EV時代に対応する接合材料・実装技術</p> <p>神谷 有弘 株式会社ニホンパ 半導体基盤技術開発部 課長</p>

### JPCA Show AWARDS 2023

優れた製品・技術内容や、新製品・新技術を促進させて展示会に活力を与え、総合的な技術の進歩発展を図っている出展者を表彰します。

表彰式日時: 会場についてはHPをご確認ください

半導体オプ・ザ・イヤーズ2023 受賞製品・技術発表

5月31日(水) 14:00~17:00 (受付開始13:30~)

於: セミナー会場G

### JPCA 創立60周年記念特別講演 プログラム

5月31日(水)	6月1日(木)	6月2日(金)
<p>14:30-15:30</p> <p>電子機器の歴史/展望</p> <p>エレクトロニクス産業とイノベーションの波</p> <p>片山 幹雄 東京大学 生産技術研究所 研究副長 株式会社KONCEPT 代表取締役社長(元シャープ社長)</p>	<p>14:30-15:30</p> <p>空飛ぶ自動車</p> <p>空飛ぶクルマ時代のビジネスについて</p> <p>浅井 尚 エアモビリティ株式会社 代表取締役社長兼CEO</p>	<p>14:30-15:30</p> <p>半導体/実装技術</p> <p>新たな世界的半導体イノベーション時代の幕開け</p> <p>小池 淳義 Rapidus株式会社 代表取締役社長</p>

### JISSO PROTEC 特別講演

5月31日(水)	6月1日(木)	6月2日(金)
<p>10:30-11:20</p> <p>スマートフォン・周辺機器業界見通し</p> <p>みずほ証券株式会社 エキサイト調査部 中根 康夫 シニアアナリスト</p>	<p>10:30-11:20</p> <p>JEITA 2022年度版実装技術ロードマップ「注目される市場と電子機器群」 ~脱コロナ・脱炭素を加速する新市場~</p> <p>西村 隆 JEITA Jisso 技術ロードマップ専門委員会 委員長 三菱電機株式会社 先端総合研究所 パワーモジュール技術部 主任研究員</p>	<p>10:30-11:20</p> <p>EV時代に対応する接合材料・実装技術</p> <p>神谷 有弘 株式会社ニホンパ 半導体基盤技術開発部 課長</p>

### JIEP 最先端先端技術シンポジウム

聴講するには事前登録のうえ、聴講料の支払いが必要となります(VIP登録された場合も有ります)。会員区分によって聴講料が異なります。詳細・登録はHPよりご確認ください。 [www.jpccashow.com/show2023/](http://www.jpccashow.com/show2023/)

※マークがついている講演資料は講演データ(有料)に含まれません

### Electronics Component & Unit Show 特別講演

5月31日(水)	6月1日(木)	6月2日(金)
<p>15:45-16:30</p> <p>眼鏡フレーム技術を活かしたARグラスの産官学共同開発事例の紹介</p> <p>福井県工業技術センター 機械・金属部 デジタル技術研究 G 主任研究員 戸原 彰彰</p>	<p>15:45-16:30</p> <p>光導波路型合波器を用いたレーザー走査型映像投影装置の超小型化</p> <p>福井大学 産学連携本部 中尾 基 特命助教</p>	<p>15:45-16:30</p> <p>エレクトロニクスの用途拡大 ~スポーツ分野への応用~(仮)</p> <p>CBC(株) New Business Department スポーツビジネスユニット プロジェクトリーダー 塚本 淳二</p>

### JPCA プリント配線板技術ロードマップセミナー

聴講料: 有料 事前登録 会議棟7階 701+702会議室

5月31日(水)	6月1日(木)	6月2日(金)
<p>13:00-14:00</p> <p>2023年度版プリント配線板技術ロードマップ総論</p> <p>宇都宮 久雄 インターコネクション・テクノロジーズ株式会社 代表取締役社長</p>	<p>13:00-14:00</p> <p>半導体市場動向</p> <p>山本 義雄 みずほ証券株式会社 代表取締役</p>	<p>13:00-14:00</p> <p>E-Textile/Wearable セミナー</p> <p>E-Textileアプリケーション(仮)に向けたワイガヤ座敷会進捗報告セミナー</p> <p>才田 義典 奈良女子大学 生活工学共同専攻 教授・学長補佐 他(予定)</p>

### PROTEC セミナー

5月31日(水)	6月1日(木)	6月2日(金)
<p>11:45-12:30</p> <p>SDGsやカーボンニュートラルにフィットした後工程プロセスの省人化に貢献するデイスパンス技術の紹介</p> <p>新井 武 武蔵エンジニアリング株式会社 マーケティング戦略部 マーケティング戦略部 係長</p>	<p>11:45-12:30</p> <p>DX時代のスマートな部品管理の秘訣</p> <p>藤原 可奈乃 JUKI株式会社 営業センター ISMソリューション部 ISM推進グループ</p>	<p>11:45-12:30</p> <p>実装技術から見える実装技術動向と持続的ものづくり</p> <p>武野 勉 株式会社ニホンパ 実装技術部 営業企画部 マーケティング課</p>

### JPCA プリント配線板技術ロードマップセミナー

5月31日(水)	6月1日(木)	6月2日(金)
<p>14:00-15:00</p> <p>高速通信システム</p> <p>西尾 俊彦 株式会社SBRテクノロジーズ</p>	<p>14:00-15:00</p> <p>半導体パッケージ技術動向</p> <p>宇都宮 久雄 インターコネクション・テクノロジーズ株式会社 代表取締役社長</p>	<p>14:00-15:00</p> <p>品質管理の基礎</p> <p>榎本 正男 株式会社バヨオフィス 代表取締役</p>

### [JEITA] 半導体パッケージングセミナー

各日10:30~11:15 / 11:30~12:15実施予定 ※詳細は決まり次第HPにアップいたします。

5月31日(水)	6月1日(木)	6月2日(金)
<p>14:00-16:00</p> <p>E-Textile/Wearable セミナー</p> <p>E-Textileアプリケーション(仮)に向けたワイガヤ座敷会進捗報告セミナー</p> <p>才田 義典 奈良女子大学 生活工学共同専攻 教授・学長補佐 他(予定)</p>	<p>14:00-16:00</p> <p>品質管理の基礎</p> <p>榎本 正男 株式会社バヨオフィス 代表取締役</p>	<p>14:00-16:00</p> <p>製品安全セミナー</p> <p>製品安全セミナー</p> <p>榎本 正男 株式会社バヨオフィス 代表取締役</p>

### JPCA プリント配線板技術ロードマップセミナー

5月31日(水)	6月1日(木)	6月2日(金)
<p>15:00-16:00</p> <p>高速通信システム</p> <p>西尾 俊彦 株式会社SBRテクノロジーズ</p>	<p>15:00-16:00</p> <p>半導体パッケージ技術動向</p> <p>宇都宮 久雄 インターコネクション・テクノロジーズ株式会社 代表取締役社長</p>	<p>15:00-16:00</p> <p>品質管理の基礎</p> <p>榎本 正男 株式会社バヨオフィス 代表取締役</p>

### JEITA 半導体パッケージングセミナー

各日10:30~11:15 / 11:30~12:15実施予定 ※詳細は決まり次第HPにアップいたします。

5月31日(水)	6月1日(木)	6月2日(金)
<p>14:00-16:00</p> <p>E-Textile/Wearable セミナー</p> <p>E-Textileアプリケーション(仮)に向けたワイガヤ座敷会進捗報告セミナー</p> <p>才田 義典 奈良女子大学 生活工学共同専攻 教授・学長補佐 他(予定)</p>	<p>14:00-16:00</p> <p>品質管理の基礎</p> <p>榎本 正男 株式会社バヨオフィス 代表取締役</p>	<p>14:00-16:00</p> <p>製品安全セミナー</p> <p>製品安全セミナー</p> <p>榎本 正男 株式会社バヨオフィス 代表取締役</p>

### JPCA プリント配線板技術ロードマップセミナー

5月31日(水)	6月1日(木)	6月2日(金)
<p>16:00-17:00</p> <p>多層プリント配線板ロードマップ</p> <p>戸田 光昭 株式会社メイコー</p>	<p>16:00-17:00</p> <p>半導体パッケージング用サブストレート</p> <p>加藤 功 凸版印刷株式会社 代表取締役</p>	<p>16:00-17:00</p> <p>製品安全セミナー</p> <p>製品安全セミナー</p> <p>榎本 正男 株式会社バヨオフィス 代表取締役</p>

### E-Textile/Wearable セミナー

聴講料: 無料 事前登録不要 セミナー会場B

5月31日(水)	6月1日(木)	6月2日(金)
<p>14:00-16:00</p> <p>E-Textile/Wearable セミナー</p> <p>E-Textileアプリケーション(仮)に向けたワイガヤ座敷会進捗報告セミナー</p> <p>才田 義典 奈良女子大学 生活工学共同専攻 教授・学長補佐 他(予定)</p>	<p>14:00-16:00</p> <p>品質管理の基礎</p> <p>榎本 正男 株式会社バヨオフィス 代表取締役</p>	<p>14:00-16:00</p> <p>製品安全セミナー</p> <p>製品安全セミナー</p> <p>榎本 正男 株式会社バヨオフィス 代表取締役</p>

### JPCA プリント配線板技術ロードマップセミナー

5月31日(水)	6月1日(木)	6月2日(金)
<p>16:00-17:00</p> <p>多層プリント配線板ロードマップ</p> <p>戸田 光昭 株式会社メイコー</p>	<p>16:00-17:00</p> <p>半導体パッケージング用サブストレート</p> <p>加藤 功 凸版印刷株式会社 代表取締役</p>	<p>16:00-17:00</p> <p>製品安全セミナー</p> <p>製品安全セミナー</p> <p>榎本 正男 株式会社バヨオフィス 代表取締役</p>

### 経済安全保障セミナー

聴講料: 無料 事前登録不要 セミナー会場D

5月31日(水)	6月1日(木)	6月2日(金)
<p>13:00-14:00</p> <p>2023年度版プリント配線板技術ロードマップ総論</p> <p>宇都宮 久雄 インターコネクション・テクノロジーズ株式会社 代表取締役社長</p>	<p>13:00-14:00</p> <p>半導体市場動向</p> <p>山本 義雄 みずほ証券株式会社 代表取締役</p>	<p>13:00-14:00</p> <p>E-Textile/Wearable セミナー</p> <p>E-Textileアプリケーション(仮)に向けたワイガヤ座敷会進捗報告セミナー</p> <p>才田 義典 奈良女子大学 生活工学共同専攻 教授・学長補佐 他(予定)</p>

### JPCA プリント配線板技術ロードマップセミナー

5月31日(水)	6月1日(木)	6月2日(金)
<p>13:00-14:00</p> <p>2023年度版プリント配線板技術ロードマップ総論</p> <p>宇都宮 久雄 インターコネクション・テクノロジーズ株式会社 代表取締役社長</p>	<p>13:00-14:00</p> <p>半導体市場動向</p> <p>山本 義雄 みずほ証券株式会社 代表取締役</p>	<p>13:00-14:00</p> <p>E-Textile/Wearable セミナー</p> <p>E-Textileアプリケーション(仮)に向けたワイガヤ座敷会進捗報告セミナー</p> <p>才田 義典 奈良女子大学 生活工学共同専攻 教授・学長補佐 他(予定)</p>

### 熱関連セミナー

聴講料: 無料 事前登録不要 セミナー会場B

5月31日(水)	6月1日(木)	6月2日(金)
<p>13:00-14:00</p> <p>2023年度版プリント配線板技術ロードマップ総論</p> <p>宇都宮 久雄 インターコネクション・テクノロジーズ株式会社 代表取締役社長</p>	<p>13:00-14:00</p> <p>半導体市場動向</p> <p>山本 義雄 みずほ証券株式会社 代表取締役</p>	<p>13:00-14:00</p> <p>E-Textile/Wearable セミナー</p> <p>E-Textileアプリケーション(仮)に向けたワイガヤ座敷会進捗報告セミナー</p> <p>才田 義典 奈良女子大学 生活工学共同専攻 教授・学長補佐 他(予定)</p>

### JPCA プリント配線板技術ロードマップセミナー

5月31日(水)	6月1日(木)	6月2日(金)
<p>13:00-14:00</p> <p>2023年度版プリント配線板技術ロードマップ総論</p> <p>宇都宮 久雄 インターコネクション・テクノロジーズ株式会社 代表取締役社長</p>	<p>13:00-14:00</p> <p>半導体市場動向</p> <p>山本 義雄 みずほ証券株式会社 代表取締役</p>	<p>13:00-14:00</p> <p>E-Textile/Wearable セミナー</p> <p>E-Textileアプリケーション(仮)に向けたワイガヤ座敷会進捗報告セミナー</p> <p>才田 義典 奈良女子大学 生活工学共同専攻 教授・学長補佐 他(予定)</p>

### 高信頼性車載用電子回路評価基準ガイドラインセミナー

聴講料: 無料 事前登録不要 セミナー会場C

5月31日(水)	6月1日(木)	6月2日(金)
<p>10:30-11:15</p> <p>高信頼性車載用電子回路評価基準ガイドラインセミナー</p> <p>浦西 泰弘 JPCA 高信頼性車載用電子回路評価基準WG 幹事</p>	<p>10:30-11:15</p> <p>高信頼性車載用電子回路評価基準ガイドラインセミナー</p> <p>浦西 泰弘 JPCA 高信頼性車載用電子回路評価基準WG 幹事</p>	<p>10:30-11:15</p> <p>高信頼性車載用電子回路評価基準ガイドラインセミナー</p> <p>浦西 泰弘 JPCA 高信頼性車載用電子回路評価基準WG 幹事</p>

### JPCA プリント配線板技術ロードマップセミナー

5月31日(水)	6月1日(木)	6月2日(金)
<p>13:00-14:00</p> <p>2023年度版プリント配線板技術ロードマップ総論</p> <p>宇都宮 久雄 インターコネクション・テクノロジーズ株式会社 代表取締役社長</p>	<p>13:00-14:00</p> <p>半導体市場動向</p> <p>山本 義雄 みずほ証券株式会社 代表取締役</p>	<p>13:00-14:00</p> <p>E-Textile/Wearable セミナー</p> <p>E-Textileアプリケーション(仮)に向けたワイガヤ座敷会進捗報告セミナー</p> <p>才田 義典 奈良女子大学 生活工学共同専攻 教授・学長補佐 他(予定)</p>

### Electronics Component & Unit Show 出展者セミナー

聴講料: 無料 セミナー会場L

5月31日(水)	6月1日(木)	6月2日(金)
<p>11:20-11:50</p> <p>DXと新しいデジタルマーケティングの創出</p> <p>中橋 隆弘 東亜無線電機株式会社 ソリューション開発部</p>	<p>11:20-11:50</p> <p>DXと新しいデジタルマーケティングの創出</p> <p>中橋 隆弘 東亜無線電機株式会社 ソリューション開発部</p>	<p>11:20-11:50</p> <p>DXと新しいデジタルマーケティングの創出</p> <p>中橋 隆弘 東亜無線電機株式会社 ソリューション開発部</p>

### ダントツものづくりセミナー

聴講料: 無料 事前登録不要 セミナー会場C

5月31日(水)	6月1日(木)	6月2日(金)
<p>13:00-13:45</p> <p>リーンなもののづくりセッション</p> <p>特別講演1) 飛躍的な生産性を実現する 全体最適の働き方イノベーション</p> <p>岸原 裕司 ゴールドラット・コンサルティング・ジャパン株式会社 CEO</p>	<p>13:00-13:45</p> <p>危機対応ものづくり / 6Sigmaの経営 / DXセッション</p> <p>特別講演2) 危機対応で進化するグローバルサプライチェーンとのづくり</p> <p>新井 健二 東京大学大学院経済学研究科教授 経済学博士</p>	<p>13:00-13:45</p> <p>ROA / 管理会計セッション</p> <p>特別講演4) トヨタ現場管理</p> <p>田中 正和 トヨタ自動車OB ものづくり大学名誉教授 / J-Comit 研究所代表</p>

### JIEP アカデミックプラザ

聴講料: 無料 事前登録不要 セミナー会場E

5月31日(水)	6月1日(木)	6月2日(金)
<p>13:00-13:20</p> <p>深層学習を用いた動体認識システムにおける使用率の検討</p> <p>長野工業高等専門学校 長野工業高等専門学校</p>	<p>13:00-13:20</p> <p>深層学習を用いた動体認識システムにおける使用率の検討</p> <p>長野工業高等専門学校 長野工業高等専門学校</p>	<p>13:00-13:20</p> <p>深層学習を用いた動体認識システムにおける使用率の検討</p> <p>長野工業高等専門学校 長野工業高等専門学校</p>

\*プログラムは都合により変更になる場合がありますので、予めご了承ください。

\*本招待状に掲載のプログラムは、予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。講演当日は早目の受付にご協力をお願いいたします。

展示ホール	セミナー会場 G	NPIセミナー会場①	展示ホール	セミナー会場 M	NPIセミナー会場②
10:55-11:15	小型電子部品の筐体接着、防水・防塵シーリング処理、潤滑剤塗布を精密ホットメルトディスペンサーで実現！ ノードン様		液晶ポリマー (LCP) 材料と繊維製品、電子部品への応用		
11:35-11:55	表面改質の最新技術をご紹介！ (コーティング不要)の撥液処理による液滴精度の向上、ガス不要の還元処理) 株式会社半導体		新商品フレキシブル基板 (FPC)		
12:15-12:35			あらゆる計測器を同時監視！ソフトウェア開発歴26年の実績で挑む、IoT技術の新たな付加価値。 株式会社エージェンシー		
13:35-13:55			エッジコンピューティングとクラウドの融合 Izuma Networks		
14:15-14:35			高誘電率BTレジン積層材料の紹介 三菱ガス化学様		
14:55-15:15			自由自在な多段階配置で大小部品混載一括実装を実現するマルチステップマスク レーザーステップステーションの特長と性能 株式会社ブルックスジャパン		
10:55-11:15	ウソコ電機の露光装置とエキシマ照射装置		IHリフローで実現する新しいものづくり 低耐熱・高放熱基板上での部品実装を量産まで対応 超低消費電力で、製造工程でのCO <sub>2</sub> 削減、SDGsに貢献 株式会社ウソコ電機		
11:35-11:55	基板及び電子部品加工向けレーザ加工機のご紹介 蓋谷工業様		フレキシブル基板+ワイヤハーネス 株式会社フアンダーフューチャーコーポレーション		
12:15-12:35			パワーデバイス材料の絶縁性能評価技術のご紹介 株式会社ミックス		
12:55-13:15	CAD/CAMデータを活用したデータダイレクトソリューション ダイナトロン様		FC-BGA 向け次世代BTレジン積層材料の紹介 三菱ガス化学様		
13:35-13:55	新フィルム塗布システムの誕生 Shimada Appli (合)		マッチ箱サイズの超コンパクトレーザ、MatchBoxシリーズの最新の動向とアプリケーション事例についてご紹介いたします。 フォトテクニカ様		
14:15-14:35	BGA実装基板検査の課題を解決するJTAG/(バウンダリスキャン)テストのご紹介 株式会社、テクノロジ		プリント基板製造工程用研磨ホイール新商品のご紹介 《SR前パフカス詰まり対応研磨ホイール》 《穴埋めインク除去用研磨ホイール》 金井重要工業様		
14:55-15:15	インクジェット塗布技術紹介 株式会社表記		基板にダメージを与えず微小部を確実に除去するために~Teknekのクリーニングの化学~ 株式会社ブルックスジャパン		
16:15-16:35			DXと新しいデジタルマーケティングの創出 東亜無線電機様		
10:15-10:35	パワー半導体向け3Dプレス技術とシンタリング (焼結) 装置開発のご紹介 日機装機		基板分割はレーザークットの時代へ LPKFレーザードバネリング (基板分割) 最新情報をお届け LPKF Laser & Electronics様		
10:55-11:15	素材の特性を見える化する！エレクトロニクス材料の熱分析と粘弾性測定 ティール・エイ・インスツルメント・ジャパン様		ファナックロボットの最新技術 ファナック様		
11:35-11:55			電子回路基板用ドリル、ルーターの最新技術情報 ユニオンツール様		
12:15-12:35			電子部品・半導体製造工程でのDLC (ダイヤモンド・ライク・カーボン) コーティング活用事例。5G通信帯域で使用可能な低誘電率DLCなど、各種機能性DLCの紹介。 株式会社プラズマイオンアシスト		
12:55-13:15	カーボンニュートラル、低応力接合に対応可能な各種低温硬化型接着材料およびはんだペーストの紹介 日邦産業様		大口径ピッチ / 高速伝送用途 / 次世代FOWLPおよびFOPLP向け 奥野製薬工業の半導体パッケージ基板用 硫酸銅めっき添加剤 奥野製薬工業様		
13:35-13:55	プリント基板設計 AI 自動配置ソリューションのご紹介 株式会社オンテック		LTSpiceをPCB設計に活用する。 (SW電源部のトレースやVIAのインダクタンス成分に注目して) 株式会社三共社		

OITDAセミナー「産業の高度化・微細化に貢献する光・レーザ技術」 **無料** **要事前登録** 会議棟1階 102会議室

5月31日 (水)	小谷 泰久 (一財) 光産業技術振興協会 副理事長兼専務理事
10:25-10:30	主催者挨拶
10:30-11:15	レーザ加工のアライアンス取り組み (仮) 小林 洋平 東京大学 物性研究所 附属極端光・レントゲン科学研究センター 教授
11:15-12:00	プリント基板加工の現状と将来 (仮) 金田 充弘 三菱電機様
13:00-13:45	スマートグラス関連 (仮) 高木 将行 セイコーエプソン様
13:45-14:30	マイクロ・ナノフォトニクス欧州エコシステムの可能性を探る (仮) カルロス・リー European Photonics Industry Consortium (EPIC) Director General
14:30-15:15	Trends and Opportunities in the Photonics Industry ホセ・ボソ OPTICA (USA)

interOpto/Imaging Japan 次世代通信に向けた光電融合技術セミナー **無料** **要事前登録** セミナー会場 J

6月1日 (木)	山本 直寛 (国研) 情報通信研究機構 ネットワーク研究所 フォトニックICT研究センター・副センター長 / 先端ICTデバイスラボ・ラボ長 (兼任)
13:00-13:50	Society5.0時代の大容量情報通信を支える光・電波融合デバイス・システム基盤技術
13:50-14:30	光電融合を支えるハイブリッド光デバイスの開発 岡本 浩行 阿南工業高等専門学校 創造技術工学科 情報コース 教授
14:30-15:10	集積光コム光源 (マイクロコム) と通信への応用 久世 直也 徳島大学ポストLEDフォトニクス研究所 次世代光研究部門 准教授
15:10-15:40	フォトニックサイエンステクノロジーのファイバー製造技術とファイバ (部品) 開発技術 小林 社一 フォトニックサイエンステクノロジー様 代表取締役社長

テラヘルツテクノロジーフォーラム 第15回テラヘルツビジネスセミナー (THz.biz 2023) ~テラヘルツセンシングの応用展開~ **無料** **要事前登録** セミナー会場 J ※展示会場 (要事前登録) + Zoom 配信 (ハイブリッド開催)

5月31日 (水)	林 伸一 株式会社テラテック (情報通信研究機構) 戦略企画委員長
13:00-13:05	開会あいさつ/プログラム案内
13:05-13:35	THz (300GHz) 対応 Beyond5G/6G 向けアンテナ計測と空間電波可視化技術 杉山 武史 株式会社フォトニックエッジ 代表取締役
13:35-13:55	講演タイトル調整中 碓 智文 株式会社ヘルデザイン 部長
13:55-14:25	講演タイトル調整中 芹田 和剛 大阪大学 経営企画オフィス 准教授
14:25-14:45	Beyond 5G に向けた材料・デバイスの周波数特性計測システムのご紹介 加藤 英志 株式会社バドテスト 新事業推進室 TAspマネージャー
14:45-15:15	講演タイトル調整中 門内 靖明 東京大学大学院 情報理工学系研究科 システム情報学専攻 准教授
15:15-15:35	300GHzフォックスルーポディエスキャナーの開発 大谷 知行 (国研) 理化学研究所 チームリーダー
15:35-15:50	まとめ+NICFフレームワーク 齋藤 伸吾 (国研) 情報通信研究機構 (テラテックフォーラム) 主任研究員

interOpto/Imaging Japan 企業プレゼンテーション **無料** **事前登録不要** セミナー会場 J

5月31日 (水)	フォトテクニカ様
11:30-11:50	高性能スキャニングオートコリレータ pulseCheckシリーズ紹介： 独国 APE 社製
12:05-12:25	銅箔複合材料による次世代ソフトエレクトロニクスデバイスの放熱設計への展開 株式会社 UBE
6月1日 (木)	株式会社 純島津製作所
10:30-11:00	同時多波長測定を可能にするポリクロメータ式 光スベアのご紹介

Keynote Speech

5月31日 (水)	上野 聡志 MODE, Inc. VP of Business
14:40-15:30	世界のトレンドからみたメーカーのトレンドとコトへの転換
6月1日 (木)	研究センター長
10:15-11:05	スマートセンシングとインターパス 持丸 正明 (国研) 産業技術総合研究所 人間拡張研究センター 研究センター長
11:35-12:25	<ピッチステージ> 社会実装に進む磁歪振動発電機の製品開発と将来展望 未定
6月2日 (金)	株式会社 三共社
11:35-12:00	構内物流の自動化で実現するオペレーションの効率改善 三共 健二 株式会社 イノベーション戦略事業本部 スマートシティ&モビリティ事業部 課長
12:00-12:25	ライブデモで実演!! ヒト・モノの移動における無人化を見据えて ~モビリティデータ活用を取り組み~ 上原 拓 株式会社 イノベーション戦略事業本部 スマートシティ&モビリティ事業部

interOpto/Imaging Japan 計測・分析・解析技術セミナー **無料** **要事前登録** セミナー会場 J

6月1日 (木)	サイバネットシステム様
11:15-11:45	講演タイトル調整中
11:45-12:15	3D外觀検査のためのレーザ構造化照明を実現するDOE技術 川島 勇人 株式会社ベースフォトン 代表取締役

interOpto/Imaging Japan スマートライフ向け光デバイス最新動向セミナー **無料** **要事前登録** セミナー会場 J

6月2日 (金)	吉本 直人 公立千歳科学技術大学 理工学部電子光工学科 教授
10:30-11:10	ドローンを活用した農林水産業のスマート化
11:10-11:40	"Improving Life with Photons" ("光"で生活を豊かにする) (仮) Luminus Devices社 / 丸文様
11:40-12:10	タイトル調整中 鈴木 敦志 E&E evolution様 代表取締役

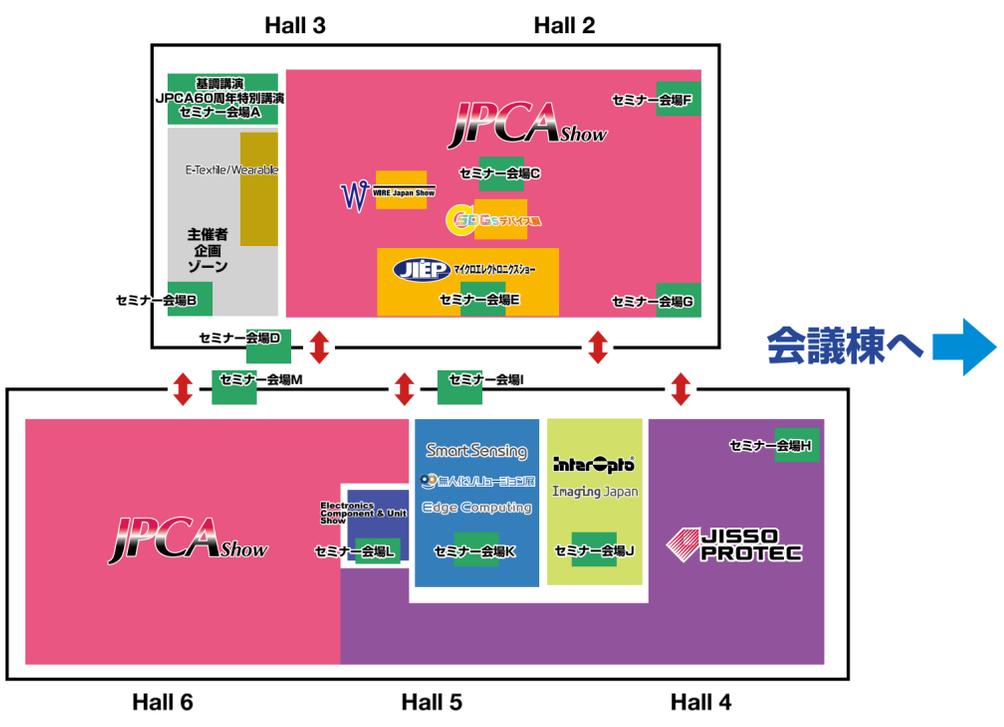
interOpto/Imaging Japan スマートファクトリー向けカメラ・センサー・システム最新技術セミナー **無料** **要事前登録** セミナー会場 J

6月2日 (金) 13:00-14:30 講演タイトル・講演者は調整中

注目される光技術セミナー **無料** **事前登録不要** セミナー会場 J

5月31日 (水) ~ 6月2日 (金) 講演時間・タイトル・講演者は調整中

展示ホール内ゾーニング



会議棟へ

出展者一覧

2023年3月22日 (水) 現在 (展示会別・50音順)

<p><b>スポンサー企業</b></p> <p><b>プラチナ</b> アドテックエンジニアリング イ・エス・アイ・ジャパン メコー</p> <p><b>ゴールド</b> アドテックジャパン イ・エス・アイ・ジャパン FICT ダイナトロン 太陽インキ製造 マダニキ ソリューションズ・ジャパン メック</p> <p><b>シルバー</b> 京亨 松和産業</p> <p><b>ブロンズ</b> 金井重要工業 JPCAめっき委員会 東亜無線電機 ニカン工業</p> <p><b>JPCA Show</b> プリント配線板技術展</p> <p>IMV IDA アイエ 鉅峰企業 actinno アスマ アドテックエンジニアリング アドテックジャパン アルメックステクノロジー イ・エス・アイ・ジャパン 石井表記 石原ケミカル いすゞ製作所 出雲市 利送イーエムシー イカワテクノファブリス 伊原電子工業 イキ インスペク インタースタート WECC (世界電子回路業界団体協議会) ウソコ電機 HAA 光学 HKPCA (香港線路板協会) エイト工業 エーティージー ルーサー アンド メルツァー FICT LPKF Laser &amp; Electronics オク製作所 オツカ光学 大船企業日本 オカダジーエーエイ オンテック 鹿児島県 華正新材料 金井重要工業</p>	<p>カネカ 広東駿亞電子科技 北川精機 協栄プリント技研 京亨 清川メッキ工業 熊本県 クラボウ KFE Hong Kong KPCA (韓国電子回路産業協会) ケムシロ ケムシロ 公安調査庁 合成樹脂工業協会 神戸大学工学部 電気電子工学専攻 塚本・寺田研究室 Goal Searchers, ZHUHAI Korea Packaging Integration Association (KPIA) コムシステムテクノ 相模ヒューマン 船橋半導体 山本化学 三東技研工業 CPCA (中国電子回路行业协会) ジェイティイーエム J-RAAS JCU SHENGYI TECHNOLOGY 四合電仕電子科技 四国化成工業 蓋谷工業 藤裕可 島根富士通 JADASON Enterprises ジャロ工業 JIANGXI JIANGNAN NEW MATERIAL TECHNOLOGY SHANDONG SHENGQUAN NEW MATERIALS Schmoll Maschinen 松和産業 ショウダクトロン スライ電子工業 伸光製作所 新興電気 深圳市ニューセス実業 SHENZHEN JINZHOU PRECISION TECHNOLOGY Shenzhen Mason Electronics SCREEN PEソリューションズ ステラ ステラ・コーポレーション 大成ラミネーター ダイセル ダイトロン 大日光・エンジニアリング 太陽インキ製造 太平洋工業 ダイワ ダイワ工業 タカノ タケウチ China Circuit Technology (Shantou) チュール 角田プラン製作所 ティーン・ティーン・ジャパン TPCA (台湾電路板協会) TESTONIC テスプロ</p>	<p>TAESUNG デノラ・ペルメック デンカ 電子回路企業年金基金 電子情報技術産業協会 (JEITA) 電波新聞社 東洋マシニング・アンド・ツール 中島化学産業 ニコン / ニコンソリューションズ ニッポン工業 日興運送 ニッコー・マテリアルズ 日東紡績 日本電気研子 日放電子 ニテックアドバンステクノロジー (日-日本電産リード) 日本アプリアマテリアルズ 日本エレメント・チャールズ 日本電子回路工業会 (JPCA) 日本エレクトロニクス 日本マイクロ ハイロックス 伊東 PAN-TEC GIGAVIS ピエマックス PCBGOOGO シューマ電子 寧波聚高新材料科技 (JUJIA) ファルネース 明和産業 山下マテリアル フアンダーフューチャーコーポレーション 福田工業 富士高分子工業 フジアルループ 藤原工業 ブルックスジャパン ベアック マイクララト マコー マックエイト 丸源機工所 ミガテクノ ミロ技術研究所 三菱ガス化学 三菱電機 南知床ヒュー・情報センター ムラキ マイコー Meilink メック メルテックス モトエクス 守谷商会 山形大学 YU-FIC ヤマハフラインテック ユニオンツール リユウ工業 RIGODEN (旧・電産商事) レゾナック レヨーン工業 <b>3D-MID/パビリオン</b> Addison Clear Wave Coating EME エレクトロニクス実装学会 (JIEP) 日機装機 eX-tech 秋田化学工業 アテナ アドバンスマテリアルテクノロジー アンドールシステムサポート エスベック 大阪有機化学工業 クワザフ JNC JNC 石油化学 Shimada Appli 新菱 セラホールディングス ティール・エイ・インスツルメント・ジャパン TEGソリューションズ 電気印刷研究所 東芝ビジネスエクスパート 日邦産業 日本スベリア社 ノース ハニ化成</p>	<p><b>半導体パッケージング・部品内蔵技術展</b> アズマ ADEKA AJ エクシール 奥野製薬工業 カールツァイス 三喜製作所 JSR 世紀精密 トワック 内藤電機工業 長瀬産業 日本電気研子 日本バーンズ フジサイト フジ電工 <b>フレキシブルプリント配線板製品 出展エリア</b> ISC 藤崎企業 沖電機 GIGAVIS Korea Electronics Technology Institute シューマ電子 寧波聚高新材料科技 (JUJIA) 東海大学 東京工業大学 明和産業 東北大学 徳島大学 長野工業高等専門学校 中山研究室 日本電気研子 長野工業高等専門学校 九方研究室 野村カネセ PALMENS フォトニクス フジタ技術センター 生産改革研究部 先端システムグループ 北海道大学 工学研究科 米澤研究室 山形県工業技術センター 横浜国立大学</p>	<p>ピーエムティー 日立ソリューションズ 藤倉化成 フラスマイオンアシスト メルコセミコンダクタエンジニアリング <b>アカデミックプラザ</b> 岩手大学 エクストコム ファナック FUJI ブルックス・ジャパン パナソニック コネクト ファナック FUJI ブルックス・ジャパン プロセス・ラボ・ミクロン ペラインダストリーズ・インク ベントロン ボジンジャパン マルコム 武蔵エンジニアリング ヤマハ発動機 ルックス電子</p> <p><b>SDGsデバイス展</b> アンピス 産業タイムズ社</p> <p><b>WIRE Japan Show</b> 工業通信</p> <p><b>Electronics Component &amp; Unit Show</b> アル電子 飯田通商 NNP 岡本無線電機 グローバルディスプレイ コアスタッフ 三共社 成電社 東亜無線電機 東京電機卸商業協同組合 (TEP) 富士電機 名古屋電業 名古屋理研電業 日川電機 山口電業</p> <p><b>JISSO PROTEC</b> アユミ工業 アルファエレクトロニクス イチネン製作所 マイクビジョン エイトテクノロジ 奥田貿易 奥原電気 オムロン 化研精工 川崎重工業 サヤカ CKD JFE 構造エレクトロニクス JUKI ジュツジジャパン 設立電気工業 大洋電機産業 タムラ製作所 テクノアルファ 東京大学 東洋理研 日本マン</p>	<p>日本スベリア社 日本ミルテック 日本ロボティクス工業会 (JARA) パームジャパン ハイウエイ バスコン 日光 パナソニック コネクト ファナック FUJI ブルックス・ジャパン プロセス・ラボ・ミクロン ペラインダストリーズ・インク ベントロン ボジンジャパン マルコム 武蔵エンジニアリング ヤマハ発動機 ルックス電子</p> <p><b>Smart Sensing</b> 無人化ソリューション展 Edge Computing</p> <p>アル・ティール・シー アイ・オール・システム IDTechEx アストロン アドマークテクノ Izuma Networks YITOA マイクロテクノロジー イノベーションリサーチ エム オプトニクス社 オルソアプテ イー・アンド・イーエソリューション the international society for optics and photonics (SPIE) エム オプトニクス社 オプトニクス 韓国光産業振興会 京都光技術研究会 SMK エネルギーハーベスティングコンソーシアム グロブ 湖北工業 ジュニアルライト 金沢大学 V-COLLABO 金沢大学 振動発電研究室 グローバルイノベーション ケイエルピー コーディン コロンズ テクノロジー コネクテッドジャパン 産業技術総合研究所 ジャパンディスプレイ 住友金属鉱山 技術本部 技術企画部 センリオン ソフエージェンシー 泰興物産 ダイオームウェア タッチエンス 樟興業 デザインインターナショナル デルタテック 東海理化電機製作所 東京電機工業 東洋電機製作所 島津研究室 内藤電機町田製作所 島津研究室 内藤電機町田製作所 日信 日本結晶技術研究所 富士通コネクト フジク ボウルウェア ポリティックジャパン ホルトプラン マイクロモジュールテクノロジー マルセル マルティス ミオ・コーポレーション MODE, Inc. ものづくりロボットコム ヤマ電気 横山商会 ロボティクス普及促進センター</p> <p><b>Imaging Japan</b> ヴィ・エス・テクノロジー エバ・ジャパン サイバネットシステム 太平貿易 日進機械 三ツ波</p>
---	--	--	--	--	---